



三井金属

三井金属鉱業株式会社
東京都品川区大崎 1-11-1
郵便番号 141-8584

平成15年9月18日

報道各位

三井金属 TCP・COF における IC 実装までの一貫体制を確立

～ IC 実装メーカー ジェネシステクノロジー社との協同体制の確立～

当社 三井金属（社長 榎原 紘）は、このたび、TAB（ 1）・COF（ 2）への IC 実装および検査を事業とするジェネシステクノロジー株式会社との間で、協同体制を構築することに合意いたしました。

従来、TCP（ 3）・COF という IC パッケージの生産において、テープ材料を供給している当社と、そのアSEMBリおよび最終検査を行うジェネシステクノロジー社が、緊密な連携体制をとることで、一貫した生産対応を可能にし、顧客先へのトータルな技術サービスの提供を実現いたします。

今後両社は、生産の効率・迅速化への実現のみならず、IC 実装分野の市場開拓および技術開発においても協同して取り組んでまいります。

<TCP・COF 一貫生産体制>

現在当社は、TCP・COF 製品を販売する顧客先の IC メーカーに対し、材料である TAB・COF の各テープの供給を行っております。一方、ジェネシステクノロジー社では、TCP・COF の製造工程において IC メーカーより委託を受け、IC と TAB テープ・COF テープとの実装（Inner Lead Bonding）および最終検査を行っております。

このため、今回の当社とジェネシステクノロジー社の協同体制構築は、TCP・COF 生産において材料から製品化までの一貫した対応を可能にいたします。実装設備を持たない顧客先にとっては、生産委託の効率化と共に、TCP・COF 製品の生産および出荷までのリードタイムの短縮が実現できるというメリットがあります。

また、これらのメリットに伴い、当該連携の両社をはじめ顧客先に至るまで、市場全体の在庫圧縮が可能になります。加えて、材料と実装との工程間の開発課題の解決スピードが加速することから、量産体制の安定化が確立すると共に、更なる超ファイン化（微細回路化）や新材料開発への逸早い実現も可能となります。

<TCP・COF 市場の現状>

従来、液晶画面ドライバー向けが中心であった TCP・COF の用途が、現在、他の分野へ拡大しつつあります。特に、プラズマディスプレイ（PDP）や有機 EL 等の様々な表示体への採用が有望であり、既に PDP では同種の材料として使用されていた FPC（ 4）からの切替えが一部で始まっています。PDP の生産において、TCP の採用は大幅な部品点数の削減ができ、コストダウンに大きく寄与しています。

こうした中、昨今の TCP・COF 市場においては、従来、液晶ドライバーを手掛けたことのない IC メーカーの新規参入が目立つものの、これら顧客先は実装技術を持っていないのが実状です。このことを背景に、世界の IC メーカーやパネルメーカー等から当社に対し、IC パッケージまでの一貫した生

産対応が求められていました。

更に市場では、ますますファイン化やコストダウンの要求も強まっており、このたび、高い技術力を有する両社の協同体制実現に対しては、既に市場から多くの期待が寄せられています。

<今後の展開>

今後、プラズマディスプレイにおいて FPC から TCP・COF へ切り替わる見通しは、来年度に本格的な動きとなり、2006 年度には、ほぼ全面的に浸透するものと見込まれております。当社は、既に TAB 市場でトップシェアの実績を有しておりますが、今回の協同体制により、当該新市場においても同様に優位な地位を築き、約 70% のシェア確保を目指してまいります。

また、当該体制は、製造・販売・技術にわたり両社の事業を補完し合うことで、今後、シナジー効果を生み、相互の発展に貢献できるものと考えております。

- 1 . TAB...Tape Automated Bonding の略で、当社は、同製品でトップシェア。ポリイミド樹脂フィルムを基礎とする IC 実装用材料。テープ状で加工可能なため、量産性が高い。液晶ディスプレイ向けドライバーの大半は、当該 TAB 製品が使用されている。
- 2 . COF...Chip on Film の略。IC 接合部のベースフィルムをくり抜き、配線を露出させた TAB に対し、ベースフィルムを残して配線加工し、IC をその上に接続加工する。細かい配線ピッチが可能。液晶画面の大型化を支える次世代 IC 実装材料。
- 3 . TCP...Tape Carrier Package。TAB テープに IC を接続させた IC モジュール製品。
- 4 . FPC...Flexible Printed Circuit の略。ポリイミド樹脂フィルムを主体とした屈曲性を有するプリント配線板材料。その特性から、小型・極薄・軽量の機器に多く使用されている。

【ご参考】

ジェネシステクノロジー株式会社

IC 実装による TCP・COF のアセンブリおよび検査事業だけでなく、半導体検査サービス事業も行う独立系企業。何れの事業においても、独立系としては最大手。所沢（埼玉県入間郡）・西脇（兵庫県西脇市）・九州（大分県速見郡）の各地に拠点を有す。

- ・ 所在地 兵庫県西脇市和田町
- ・ 代表者 代表取締役社長 三浦雄三
- ・ 設立 1987 年 12 月
- ・ 資本金 19 億円
- ・ 従業員数 540 名
- ・ 事業内容 半導体検査サービス事業、半導体アセンブリ事業

以 上

【本件お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部広報室 ひしや 泥谷・浅木 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

E メール koho@mitsui-kinzoku.co.jp